

# 厚膜片式開關二極管

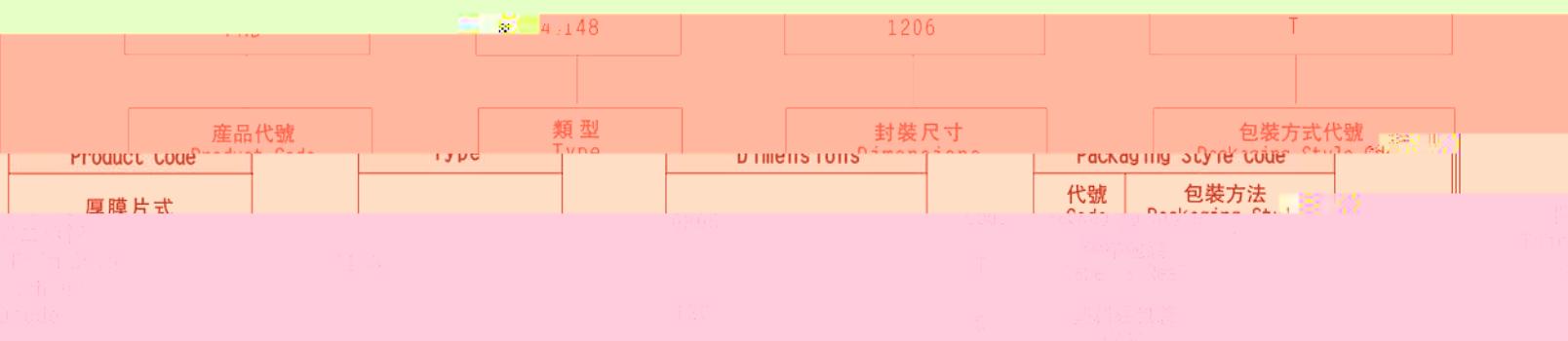
Thick Film Chip Switching Diode

## ■ 特點 Features

- 尺寸小、厚度薄，適用於高密度組裝  
Te small size, thin thickness, suitable for high density assembly

- 陶瓷基板作基體，散熱性能良好  
The ceramic substrate is used as matrix, favorable radiating performance

- 抗彎曲能力強，彎板幅度可達2mm  
The bending resistance ability, bending amplitude can reach 2mm



## 尺寸 Dimensions



## ■ 電性能 Electrical Characteristics

表1 電性能 Table 1 Electrical Characteristics

特性 Characteristics	測試條件 Test Condition	符號 Symbol	最小 Min	最大 Max	單位 Unit
擊穿電壓 Reverse Breakdown Voltage	$I_R=100\mu A$	$V_{BR}$	100	--	V
反向漏電流 Reverse Leakage Current	$V_R=75V$	$I_{R1}$	--	5.0	$\mu A$
	$V_R=20V$	$I_{R2}$	--	25	nA
正向電壓 Forward Voltage	$I_F=100mA$	$V_F1$	--	1.1	V
	$I_F=10mA$	$V_F2$	--	1.0	V
電容 Diodes Capacitance	$V_F=V_R=0V$ $F=1.0MHz$	$C_{tot}$	--	4.0	pF
反向恢復時間 Reverse Recovery Time	$I_F=I_R=10mA$	$t_{rr}$	--	4.0	ns

## ■ 額定值 Ratings

表2 額定值 Table2 Rating

額定值 Rating	符號 Symbol	標稱值 Value	單位 Unit
反向直流電壓 Continuous Reverse Voltage	$V_R$	75	Vdc
反向峰值電壓 Peak Reverse Voltage	$V_{RM}$	100	Vdc
正向連續電流 Continuous Forward Current	$I_0$	150	mA
正向重複峰值電流 Peak Forward Current	$I_{FRM}$	200	mA
正向浪涌電流 Peak Forward Surge Current( $1\mu s$ )	$I_{FSM}$	2000	mA
最大耗散功耗 Power Dissipation	$P_{tot}$	500	mW
最高等效(有效)結溫 Junction Temperature	$T_{(v)}$	175	°C
貯存溫度 Storage Temperature	$T_{sta}$	-55 to +150	°C

## ■ 參考標準 Reference Standard

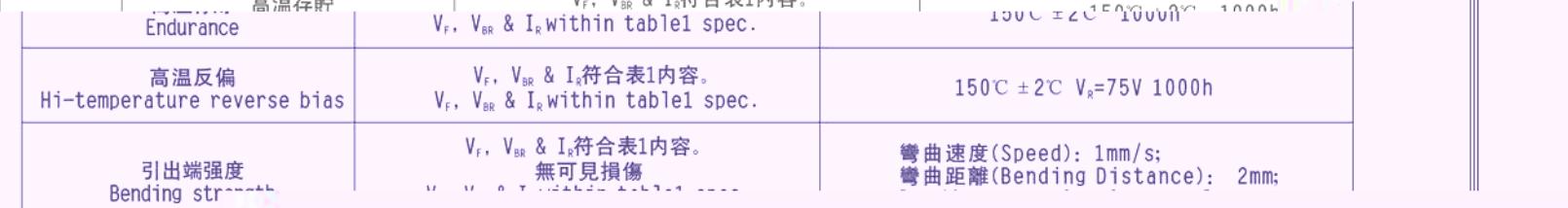
GB/T 4023-1997  
 GB/T 4589.1-2006  
 GB/T 6571-1995  
 GB/T 6588-2000

# 厚膜片式開關二極管

Thick Film Chip Switching Diode

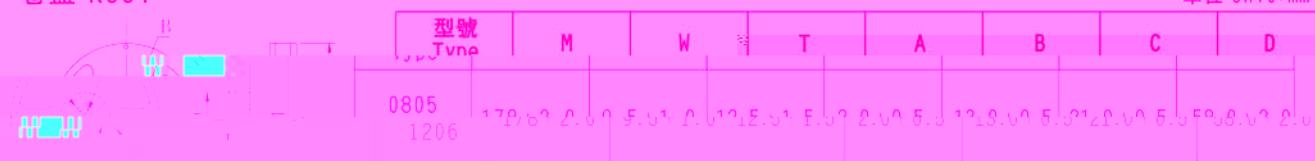
## ■ 特性 Characteristics

項目 Item	標準 Specifications	測試方法 Test Methods
可焊性 Solderability	可焊面積 > 95% 95% Cover min.	240°C ± 5°C 2s ± 0.5s
耐焊接熱 Resistance to soldering heat	V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> 符合表1內容。 V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> within table1 spec.	270°C ± 5°C 10s ± 1s
穩態濕熱 Steady state humidity	V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> 符合表1內容。 V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> within table1 spec.	40°C ± 2°C 90~95%RH 500h
溫度快速變化 Rapid change of temperature	V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> 符合表1內容。 V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> within table1 spec.	-55°C ± 3°C (30分鐘) ~ 150°C ± 2°C (30分鐘) 5個循環。 -55°C ± 3°C /30min ~ 150°C ± 2°C /30min for 5cyc.
高温存貯 Endurance	V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> 符合表1內容。 V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> within table1 spec.	150°C ± 2°C 1000h
高温反偏 Hi-temperature reverse bias	V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> 符合表1內容。 V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> within table1 spec.	150°C ± 2°C V <sub>R</sub> =75V 1000h
引出端強度 Bending strength	V <sub>F</sub> , V <sub>BR</sub> & I <sub>R</sub> 符合表1內容。 無可見損傷	彎曲速度(Speed): 1mm/s; 彎曲距離(Bending Distance): 2mm;



型號 Type	P	P0	P1	ΦUU	T
0805	4.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	2.0 ± 0.05	1.5 ± 0.1	0.95 ± 0.1
1206	4.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	2.0 ± 0.05	1.5 ± 0.1	0.95 ± 0.1

## \* 卷盤 Reel



## 包裝數量 Packaging quantity

包裝方法 Packaging style	編 帶 Tape and reel		塑料袋散裝 Case	
	型號 Type	0805	1206	0805
數量(PCS) Quantity	4000	4000	<10000	<10000